

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60191-4

1999

AMENDEMENT 2
AMENDMENT 2
2002-07

Amendement 2

**Normalisation mécanique des dispositifs
à semiconducteurs –**

**Partie 4:
Système de codification et classification
en formes des boîtiers pour dispositifs
à semiconducteurs**

Amendment 2

**Mechanical standardization of
semiconductor devices –**

**Part 4:
Coding system and classification into forms
of package outlines for semiconductor
device packages**

© IEC 2002 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

C

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 47D: Normalisation mécanique des dispositifs à semiconducteurs, du comité d'études 47 de la CEI: Dispositifs à semiconducteurs.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
47D/505/FDIS	47D/509/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de ses amendements ne sera pas modifié avant 2005. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

Page 38

Ajouter, après l'annexe A, la nouvelle annexe B suivante:

Annexe B (informative)

Création et application du système de codage descriptif – Noms courants de boîtiers

Dans les domaines du marketing ou de la publicité, des noms courants de boîtiers ou des abréviations sont souvent utilisés pour indiquer directement la forme du boîtier. A leur usage, le codage descriptif est simplifié et modifié à partir du système formel de codification, pour une application plus facile.

La structure du code pour les boîtiers courants se compose du code du matériau du corps du boîtier et d'un code modifié, à différencier au moyen d'un tiret (-) entre les deux codes.

Se reporter à 4.3.3 pour le code du matériau du corps.

Le code du boîtier modifié est créé à partir du code de type de boîtier (4.3.1), en ajoutant le code de la position des broches (4.3.2) ou celui de la forme des connexions (4.3.5) et, facultativement, le code de caractéristique spécifique du boîtier (4.3.4).

Pour éviter des confusions dues à des différences mineures entre le code courant du boîtier et le code formel, il est nécessaire de les répertorier dans la CEI 60191-4.

La figure B.1 présente la structure du codage descriptif pour les noms courants de boîtiers.

FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 47D: Mechanical standardization of semiconductor devices, of IEC technical committee 47: Semiconductor devices

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
47D/505/FDIS	47D/509/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendments will remain unchanged until 2005. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

Page 39

Add, after annex A, the following new annex B:

Annex B (informative)

Derivation and application of the descriptive coding system – Common package names

Common package names or abbreviations are often used to directly indicate the form of package in marketing or advertising fields. The descriptive coding for them is to be simplified and modified from the formal coding system for easier usage.

The structure of a common package code consists of a package-body-material code and derived package code being set off by a dash (-) between them.

The package-body-material code is referred to in 4.3.3.

The derived package code is derived from the package outline style code (4.3.1) by the addition of a terminal-position code (4.3.2) or lead-form code (4.3.5) and optionally the package-specific feature code (4.3.4).

To prevent confusion due to minor differences between the common-package code and the formal code, it is required to list them in IEC 60191-4.

Figure B.1 shows the descriptive coding structure for common package names.

Le tableau B.1 donne une liste de quelques exemples de noms courants de boîtiers et de leur code descriptif.

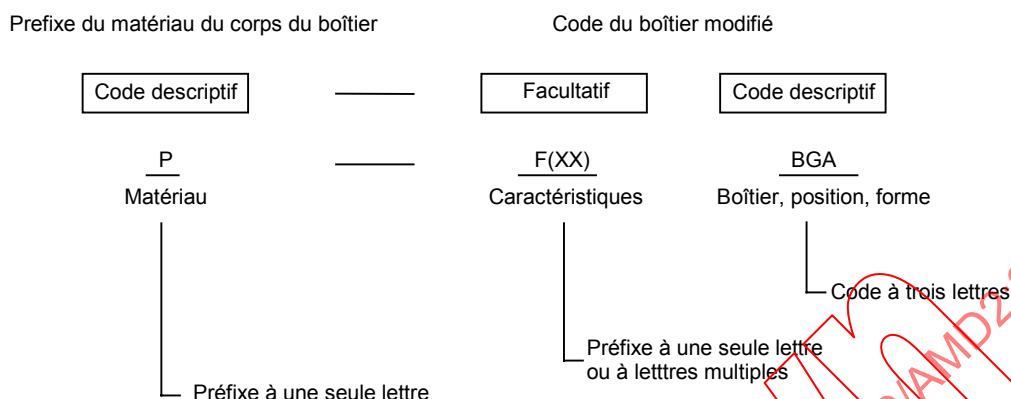


Figure B.1 – Système de codage descriptif pour un nom courant de boîtier d'un dispositif à semiconducteurs

Tableau B.1 – Exemples de noms courants de boîtiers et de code descriptif

Code de boîtier modifié	Code courant du boîtier	Nom courant du boîtier
LQFP	P-LQFP C-LQFP G-LQFP	QFP faible hauteur, en plastique QFP faible hauteur, en céramique QFP faible hauteur, en céramique, scellement verre
TQFP	P-TQFP C-TQFP	QFP mince, en plastique QFP mince, en céramique
FQFP	P-FQFP C-FQFP	QFP à pas fin, en plastique QFP à pas fin, en céramique
TSOP	P-TSOP	TSOP en plastique
SSOP	P-SSOP	SSOP en plastique
TSSOP	P-TSSOP	TSSOP en plastique
SOJ	P-SOJ	SOJ en plastique
VQFN	P-VQFN	QFN très mince, en plastique
DIP	P-DIP C-DIP G-DIP	DIP en plastique DIP en céramique DIP en céramique, scellement verre
PGA	P-PGA C-PGA	PGA en plastique PGA en céramique
BGA	P-BGA T-BGA C-BGA	BGA en plastique BGA en bande BGA en céramique
LBGA	P-LBGA	LBGA en plastique
FBGA	P-FBGA T-FBGA C-FBGA	BGA à pas fin, en plastique BGA à pas fin, en bande BGA à pas fin, en céramique